

Technology Roadmap for Printed Wiring Boards

プリント配線板 技術ロードマップ

記載言語：日本語 Language: Japanese only

こちらはダウンロード版(PDF 形式)です

This publication is a download version (PDF).

For companies located overseas, a paper version is available, and shipping charges will be charged.

JPCA/JEITA/JIEP 会員様特別価格 JPCA/JEITA/JIEP members

¥22,000 (税込) (¥22,000 including tax)

販売価格

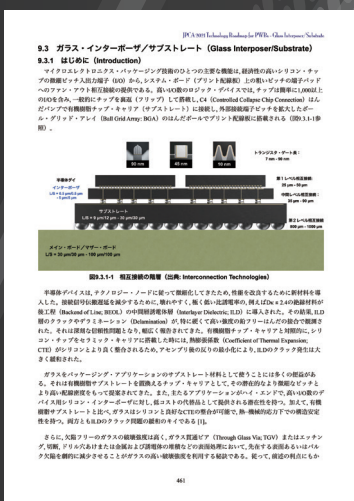
Non-member company

¥44,000 (税込) (¥44,000 including tax)

改訂のポイント Revision points

2021 年度版では、2030 年までの技術の数値動向に加え、スマート・システム・インテグレーション、高性能コンピューティング、ネットワーク機器、自動車エレクトロニクス、5G/6G 通信システムといった最新の技術をご紹介します。

In the 2021 edition, we will introduce the latest technologies such as smart system integration, high-performance computing, network equipment, automobile electronics, and 5G / 6G communication systems, in addition to the numerical accompaniment of technologies up to 2030.



※プリントアウト用に一部白紙が挿入されている個所がございます。予めご了承ください。

